

## 1000 Ω Chip resistor de película delgada de GaAs

Resistencia: 1000 Ω (típico); Corriente de funcionamiento lineal: 0.04 A (típico); Corriente máxima admisible: 0.08 A (máximo). Dimensiones del die en planta: 0.5 × 0.5 mm.



### Características eléctricas · TA = +25 °C

| Parámetro                          | Símbolo | Mínimo | Típico | Máximo | Valor | Unidad |
|------------------------------------|---------|--------|--------|--------|-------|--------|
| Número de resistencias             | -       | -      | -      | -      | 1     | -      |
| Número de terminales               | -       | -      | -      | -      | 2     | -      |
| Resistencia                        | -       | -      | 1000   | -      | -     | Ω      |
| Tolerancia de resistencia          | -       | -      | ±5     | -      | -     | %      |
| Corriente de funcionamiento lineal | -       | -      | 0.04   | -      | -     | A      |

### Valores límite

| Parámetro                  | Símbolo | Mínimo | Típico | Máximo | Unidad |
|----------------------------|---------|--------|--------|--------|--------|
| Corriente máxima admisible | -       | -      | -      | 0.08   | A      |

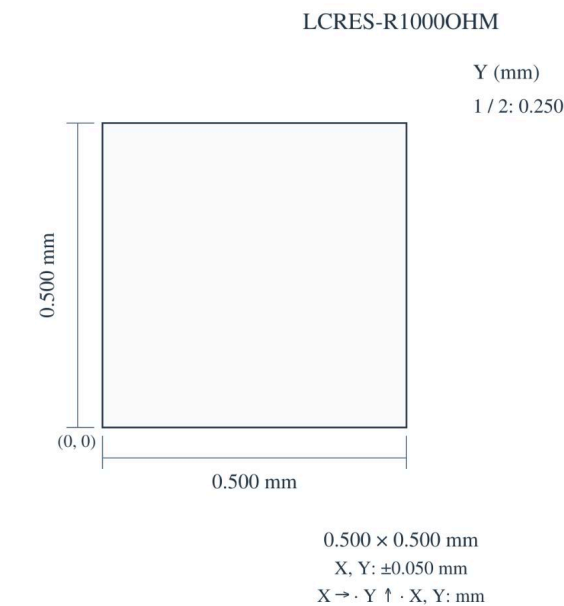
### Condiciones ambientales

| Parámetro                     | Símbolo | Mínimo | Típico | Máximo | Unidad |
|-------------------------------|---------|--------|--------|--------|--------|
| Temperatura de almacenamiento | -       | -65    | -      | 150    | °C     |
| Temperatura de funcionamiento | -       | -55    | -      | 125    | °C     |

Dimensiones del chip

| Parámetro                     | Valor     | Unidad |
|-------------------------------|-----------|--------|
| Dimensiones del die en planta | 0.5 × 0.5 | mm     |

Plano dimensional mecánico



Todas las dimensiones se indican en mm [in].

Asignación de pads de unión

| Terminales              | Símbolo | Función                  | Notas       |
|-------------------------|---------|--------------------------|-------------|
| 1, 2                    | IN/OUT  | Entrada/salida recíproca | -           |
| Cara posterior del chip | GND     | Masa                     | RF / DC GND |

Registro de la publicación actual · 1.1 · 2026-10-23. Actualización de las tablas de especificaciones. Sustituye a la revisión 1.0.

Integración del chip y secuencia de polarización

La cara posterior del chip requiere una conexión a tierra fiable.

Alcance de la referencia mecánica

Guía dimensional en mm basada en la documentación de origen. Información parcial; no constituye un plano completo de fabricación o de unión por hilos.

Aviso del documento

Las especificaciones pueden revisarse. Antes de cerrar el diseño, confirme con LCRF la revisión vigente y los requisitos específicos del producto. La oferta aprobada y la documentación del pedido definen la configuración suministrada.